

Установка измерения геометрических параметров пластин FLA-200

	Center Position		Thickness				SBID	SBIR	SF3D	SF3R	SFLD	SFLR	SFQD
	X	Y	Center	Max	Min	Ave							
1	-35.00	-85.00	748.00	748.21	747.78	747.98	-0.22	0.43	-0.22	0.40	-0.23	0.41	0.02
2	-25.00	-85.00	748.21	748.33	748.15	748.23	0.12	0.18	0.10	0.19	0.11	0.19	-0.03
3	-15.00	-85.00	748.16	748.25	747.99	748.14	-0.17	0.26	-0.14	0.20	-0.15	0.21	-0.02
4	-5.00	-85.00	748.06	748.12	747.92	748.01	-0.14	0.20	-0.13	0.17	-0.14	0.18	0.02
5	5.00	-85.00	748.05	748.09	747.94	748.03	-0.11	0.15	-0.14	0.20	-0.14	0.21	0.03
6	15.00	-85.00	748.10	748.13	748.00	748.08	-0.10	0.12	-0.07	0.11	-0.08	0.12	-0.04
7	25.00	-85.00	747.98	748.11	747.93	748.01	0.14	0.18	0.11	0.15	0.11	0.16	0.02
8	35.00	-85.00	747.87	748.10	747.62	747.84	-0.24	0.47	-0.26	0.51	-0.27	0.52	0.03
9	-55.00	-75.00	748.45	748.66	748.23	748.44	-0.21	0.42	0.20	0.39	0.21	0.41	-0.03
10	-45.00	-75.00	748.43	748.54	748.27	748.43	-0.16	0.26	-0.14	0.22	-0.15	0.23	0.04
11	-35.00	-75.00	748.44	748.53	748.35	748.45	-0.10	0.19	0.12	0.19	0.12	0.19	-0.02

Item	Judgment
SBID	NG
SBIR	NG
SF3D	NG
SF3R	NG

Item	Judgment
SBID	OK
SBIR	OK
SF3D	OK
SF3R	NG
SFLD	OK
SFLR	NG
SFQD	OK
SFQR	OK

Item	Data	Judgment
SFPD%	46.01	OK
STIR%	100.00	NG



Производитель:

Napson

Цена:

Цена по запросу

Описание

Измерения в данной системе производятся бесконтактным методом, что исключает разрушение рабочей поверхности пластины. Установка позволяет проводить измерение таких параметров пластин, как толщина, разнотолщинность (TTV), прогиб (BOW), коробление (WARP), локальная и глобальная плоскостность пластин в соответствии со стандартами ASTM. Система позволяет работать с пластинами диаметром до 300 мм. Измерение толщины производится в диапазоне 500 мкм без проведения повторной калибровки. Система позволяет проводить измерение 12,000 точек по поверхности в течение 1 минуты. Результаты картографирования поверхности могут быть представлены в виде 2D/3D изображений, возможен импорт данных в

Excel.

Область применения:

- Измерение геометрических характеристик полупроводниковых пластин Si, poly-Si, SiC, GaAs, GaN, Ge, InP, сапфира, кварца
- Контроль поверхности пластин после технологических операций дисковой/проволочной резки слитков, шлифовки, полировки, утонения, травления